

# 低压等离子清洁设备 DPC06

各式基材在印刷或黏著前之表面活化、改质、接枝、粗糙化或清洁等

## 特点

- 桌上型设计，占地面积小，不占空间
- 设备适用于学校、实验室、医疗院所与电子厂之研发单位
- 设备成本与研发成本低
- 设备操作容易，动作方式简单易懂
- 专利设计之特殊等离子电极
- 高密度等离子源
  - 处理速度快、清洁效率高、可靠度高
  - 可控制低的离子能量、不损伤基板
  - 结合化学反应性及物理撞击性
- 处理均匀性佳
- 设备可移除氧化物与硫化物
- 可使用多种制程气体
- 设备稳定高，容易维护
- 可依客户需求作更改



## 应用产业

- LCM、IC 封装 ( Flip Chip, CSP, BGA, Lead Frame, etc. )
  - LED 封装、SMT、PCB、FPC、光电元件、电子元件、封装贴合前清洁
- 印刷或黏著前之表面粗化或清洁

项目	DPC06
Footprint	650(W)×720(D)×625(H)mm
Chamber Size	300(W)×230(D)×300(H)mm
Weight	150kg
Facilities	3Ø220V×60Hz×4w, 20A Compressed air : about 6 kg/cm <sup>2</sup> Reaction gas : about 2 kg/ cm <sup>2</sup>
System control software	PC base
Vacuum pump	Rotary
Reactants	Ar
Power supply	RF or MF

